# 证券简称：灿芯股份 证券代码：688691

# 灿芯半导体（上海）股份有限公司

# 投资者关系活动记录表

# 编号：2024-002

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系**  **活动类别** | ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访  □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动  □现场参观 ☑其他（投资者交流） |
| **参与单位名称** | 国金证券、申万宏源证券、东北证券、银华基金、浙商资管、乘是资产、见合私募基金、弥远投资、璞远资产、汐泰投资、湘禾投资、胤胜资管、原点资管、重阳投资 |
| **时间** | 2024年9月24日 |
| **地点** | 公司会议室 |
| **上市公司**  **接待人员姓名** | 庄志青先生 董事长兼总经理  沈文萍女士 董事会秘书 |
| **投资者关系**  **活动主要内容**  **介绍** | 公司董事长兼总经理庄志青先生对公司2024年1-6月的经营情况进行了简要介绍：  2024年1-6月，公司实现营业收入5.94亿元，同比减少10.94%；归属于上市公司股东的净利润为8,043.34万元，同比减少25.97%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,155.10万元，同比减少24.71%。  公司业绩有所下降的原因主要系报告期内受下游客户需求波动影响，同时出于长远发展考虑，为进一步巩固和加强自身核心竞争力，公司积极推进募投项目实施，持续加大产品与技术开发力度及研发技术团队建设投入，研发费用同比增加37.24%，从而使得公司报告期内净利润等相关指标同比有所下降。与此同时，随着公司本期芯片全定制服务收入占比的上升，公司综合毛利率较上年同期增加3.59个百分点，为31.04%。  投资者提出的主要问题及公司回复情况如下：  1、公司2024年上半年营业收入情况以及变动原因？  答：按业务类型来看，公司2024年1-6月芯片设计业务收入为10,885.28万元，较去年同期下降59.18%，芯片量产业务收入为48,517.39万元，较去年同期增长21.20%。按服务类型来看，公司2024年1-6月芯片全定制服务收入为42,736.97万元，较去年同期增长15.70%，芯片工程定制服务收入为16,665.70万元，较去年同期下降44.00%。公司2024年1-6月收入下降主要原因是受下游客户需求波动影响。  2、请问公司2024年1-6月的研发投入和研发人员情况？  答：2024年上半年，公司研发费用为6,381.61万元，占公司营业收入比例为10.74%，较上年同期增加了37.24%。公司截至2024年6月末共有研发人员130人，较上年同期末研发人员增加35.42%。  3、公司毛利率变化的主要原因是什么？  答：按服务类型来看，公司2024年1-6月芯片全定制服务收入为42,736.97万元，较去年同期增长15.70%，芯片工程定制服务收入为16,665.70万元，较去年同期下降44.00%，由于公司芯片全定制服务毛利率整体高于芯片工程定制服务毛利率，2024年1-6月芯片全定制服务收入占比的提升也带动公司毛利率提高，公司2024年上半年综合毛利率较上年同期上升3.59个百分点，为31.04%。  4、公司上半年研发方面取得了哪些具体的进展？  答：高速接口IP领域：（1）DDR：公司基于28nm HKC+工艺的72bit DDR、LPDDR IP设计验证成功，最高速率达到2,667Mbps；基于28nm HKD 2.5V工艺的DDR、LPDDR IP设计完成进入验证阶段；（2）Serdes与PCIE：公司基于28nm HKC+工艺的Serdes IP及PCIE IP设计验证成功，最高速率可达到16 Gbps；（3）MIPI：公司可满足汽车电子可靠性要求的先进工艺MIPI DPHY IP设计验证成功，最高速率可达2.5Gbps，同时公司基于28nm HKC+工艺的MIPI DPHY IP设计验证成功，最高速率可达4.5Gbps；（4）USB：公司可满足汽车电子可靠性要求的先进工艺USB 2.0 IP设计验证成功，速率可达480Mbps。同时公司基于28nm HKD 1.8V工艺的USB 2.0 IP以及基于28nm HKD 2.5V工艺的USB 2.0 IP设计完成进入验证阶段。  模拟IP领域：（1）ADC：公司40nm LL工艺16bit SAR ADC IP设计验证成功，最高采样率达到4Msps，有效位达到14bit以上；（2）PLL：公司28nm HKC+工艺PLL IP设计验证成功，最高速率达到4.5GHz；同期公司28nm HKD 1.8V工艺 PLL IP设计完成进入验证阶段以及基于28nm HKD 2.5V工艺 PLL IP设计完成进入验证阶段。  系统级芯片平台研发领域：（1）车规平台方面：公司基于40nm EFlash的车规双核锁步MCU平台已完成功能安全相关前端和DFT部分的主体设计，并进入仿真验证阶段；（2）自动测试平台方面：公司已分别实现MIPI、PCIE、DDR、ADC、RF的自动化测试系统搭建，并在实际项目中得以应用验证，测试数据的一致性有保证，测试效率大幅度提高。  5、公司一站式芯片定制服务的下游应用领域主要有哪些？  答：公司为客户提供芯片设计服务最终转化为客户品牌的芯片产品被广泛应用于物联网、工业控制、消费电子、网络通信、智慧城市、高性能计算等行业，2024年1-6月，公司营业收入按下游应用领域分类主要有消费电子（占比29%）、物联网（占比26%）、网络通信（占比25%）和智慧城市（占比13%）等。  6、公司目前的下游客户主要有哪些，收入占比如何？  答：从客户群体而言，公司下游客户主要为系统厂商和芯片设计公司，系统厂商是指面向终端应用提供整机系统设备的厂商；芯片设计公司是指从事自有品牌芯片产品设计研发及销售的企业。公司2024年上半年来自于系统厂商、芯片设计公司及其他类型客户的收入占比分别为28.30%、69.81%和1.89%。  7、公司募集资金使用情况如何？  答：截至2024年6月30日，公司已使用募集资金人民币245.67万元。同时公司已使用募集资金合计3,621.27万元置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用。 |
| **附件清单** | 无 |
| **日期** | 2024年9月24日 |
| **关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明** | 无 |